

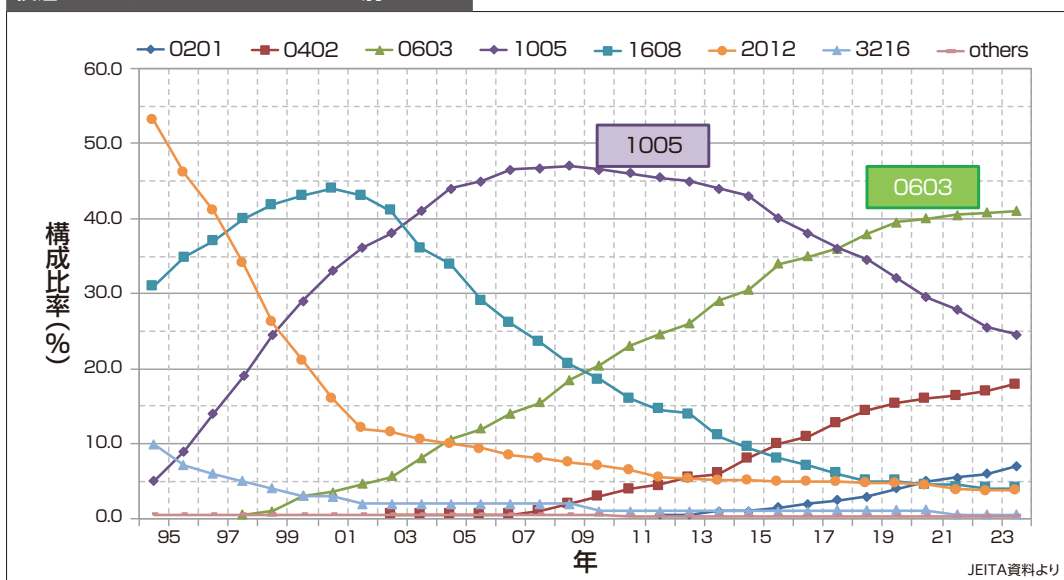
スクリーン印刷法で0603部品対応基板を実現

背景

電子機器の小型化・高性能化にともなう電子部品の小型化要求やモバイル通信機器の市場拡大により、MLCC (積層セラミックコンデンサ) は小型化・大容量化し、MLCCのサイズトレンドは0603部品にシフトしています。

1005部品の入手が困難になっており、0603部品への置き換え検討が必要となっています。

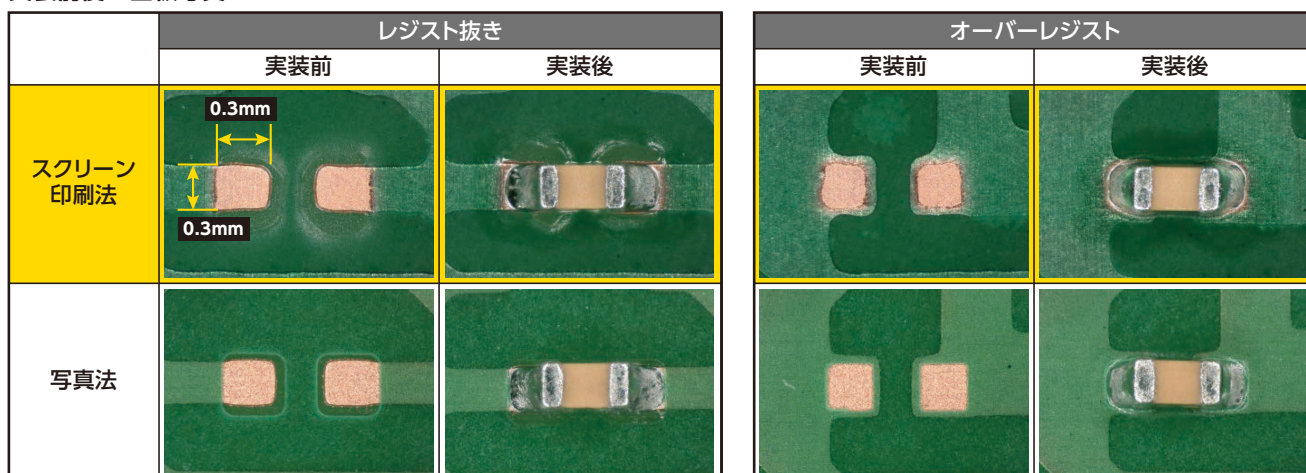
積層セラミックコンデンサのサイズ別トレンド



特長

「写真法」でしか対応できなかった0603部品が実装可能なランドを、「スクリーン印刷法」で形成します。

実装前後の基板写真



※基板仕様によっては設計変更をお願いする場合がございます。